

性能特点

- 高精度 MEMS 微米加工
- 高性能、全屏蔽、抗干扰微型腔体滤波器
- 硅基片、50Ω 共面波导输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块应用

环境参数

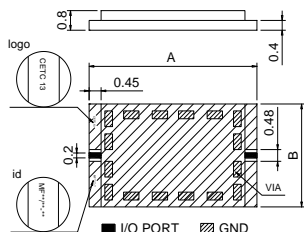
工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
最高输入功率	35dBm

电特性(T_A=+25°C)

项目	最小值	典型值	最大值	单位
中心频率(f ₀)	-	2.2	-	GHz
通带频率范围	2.0	-	2.4	GHz
带内波动	-	-	1	dB
中心插损	-	-	3.5	dB
回波损耗	12	-	-	dB
带外衰减	≥ 30@1.7GHz&2.8GHz		-	dB
	≥ 40@1.6GHz&2.9GHz		-	dB
	≥ 60@DC~1.4GHz		-	dB
	≥ 60@3.1~5.5GHz		-	dB
时延波动	≤ 1.0@2.0~2.4GHz		-	ns
线性相位	≤ ±7@2.0~2.4GHz		-	°

S2P 文件名: SiMF2R2_R4-7D3.s2p

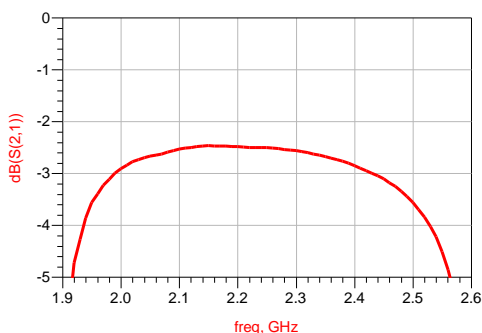
外形尺寸



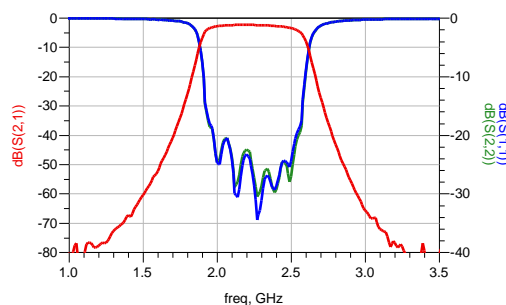
尺寸符号	数值(mm)		
	最小值	公称值	最大值
A	6.9	-	7.0
B	10.9	-	11.0

典型测试曲线

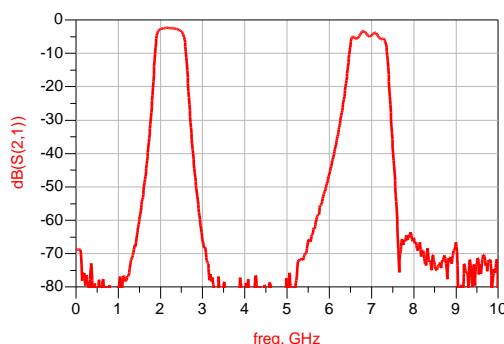
通带损耗 VS 频率(T_A=25°C)



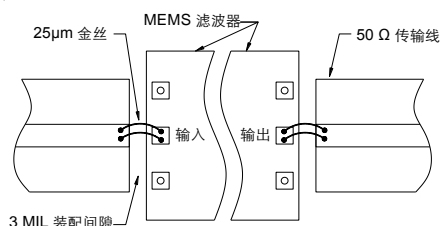
带外抑制 & 回波损耗 VS 频率(T_A=25°C)



远端抑制 VS 频率(T_A=25°C)

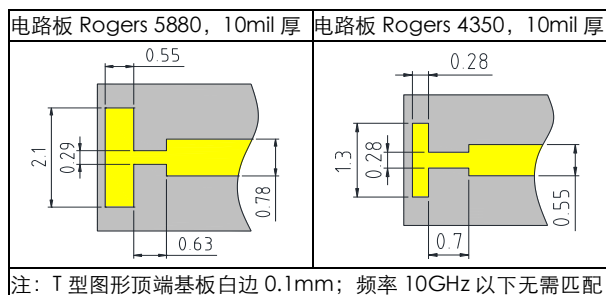


建议装配图



注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，两侧距侧壁 0.2mm，表面距上盖 3mm，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系数(2.9ppm/°C)相当的载体上，载体厚度 ≥ 0.2mm；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配，T 型尺寸如下：



注: T 型图形顶端基板白边 0.1mm; 频率 10GHz 以下无需匹配

5. 有问题请与供货商联系。